



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	半导体结构及其制造方法
专利类别:	国际专利
申请号:	PCT/CN2012/085353
申请日期:	2012-11-27
专利号:	9,401,425
第一发明人:	朱慧琰;尹海洲;骆志炯
实施情况:	授权
专利证书号:	9,401,425
其它备注:	十室

